

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2011 年 10 月 6 日(06.10.2011)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2011/122232 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/60 (2006.01) H05K 1/05 (2006.01)
H01L 23/14 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2011/054916
- (22) 国際出願日: 2011 年 3 月 3 日(03.03.2011)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2010-077064 2010 年 3 月 30 日(30.03.2010) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東レ株式会社 (TORAY INDUSTRIES, INC.) [JP/JP]; 〒1038666 東京都中央区日本橋室町 2 丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 前田昭弘 (MAEDA, Akihiro) [JP/JP]; 〒5208558 滋賀県大津市園山 1 丁目 1 番 1 号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 大野英二 (ONO, Eiji) [JP/JP]; 〒5208558 滋賀県大津市園山 1 丁目 1 番 1 号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 澤村泰司 (SAWAMURA, Yasushi) [JP/JP]; 〒5208558 滋賀県大津市園山 1 丁目 1 番 1 号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: METAL SUPPORT FLEXIBLE BOARD, METAL SUPPORT CARRIER TAPE FOR TAPE AUTOMATED BONDING USING SAME, METAL SUPPORT FLEXIBLE CIRCUIT BOARD FOR MOUNTING LED, AND COPPER FOIL-LAMINATED METAL SUPPORT FLEXIBLE CIRCUIT BOARD FOR FORMING CIRCUIT

(54) 発明の名称: 金属支持フレキシブル基板ならびにそれを用いたテープオートメテッドボンディング用金属支持キャリアテープ、LED実装用金属支持フレキシブル回路基板および回路形成用銅箔積層済み金属支持フレキシブル回路基板

(57) Abstract: Disclosed is a metal support flexible wiring board which has excellent wire bonding properties and low curling properties while maintaining excellent insulating properties and punching properties, and therefore can be subjected to a reel-to-reel process and facilitates packaging scheme and heat dissipation scheme. Specifically disclosed is a metal support flexible board comprising (1) an adhesive layer and (2) a support layer, wherein the support (2) is composed of a metal foil, and the adhesive layer (1) contains (A) a polyamide resin containing a dimer acid residue and (B) a phenol resin.

(57) 要約: 優れた絶縁性および打ち抜き特性を維持しつつ、優れたワイヤーボンディング性や低カール性を持つことから、リール to リールで加工が可能で、パッケージング設計と放熱設計が容易な金属支持フレキシブル配線板を提供すること。(1) 接着剤層と、(2) 支持体層から構成される金属支持フレキシブル基板において、(2) 支持体が金属箔にて構成されており、かつ、(1) 接着剤層が、(A) ダイマー酸残基を含むポリアミド樹脂および、(B) フェノール樹脂を含有する事の特徴とする金属支持フレキシブル基板。

WO 2011/122232 A1